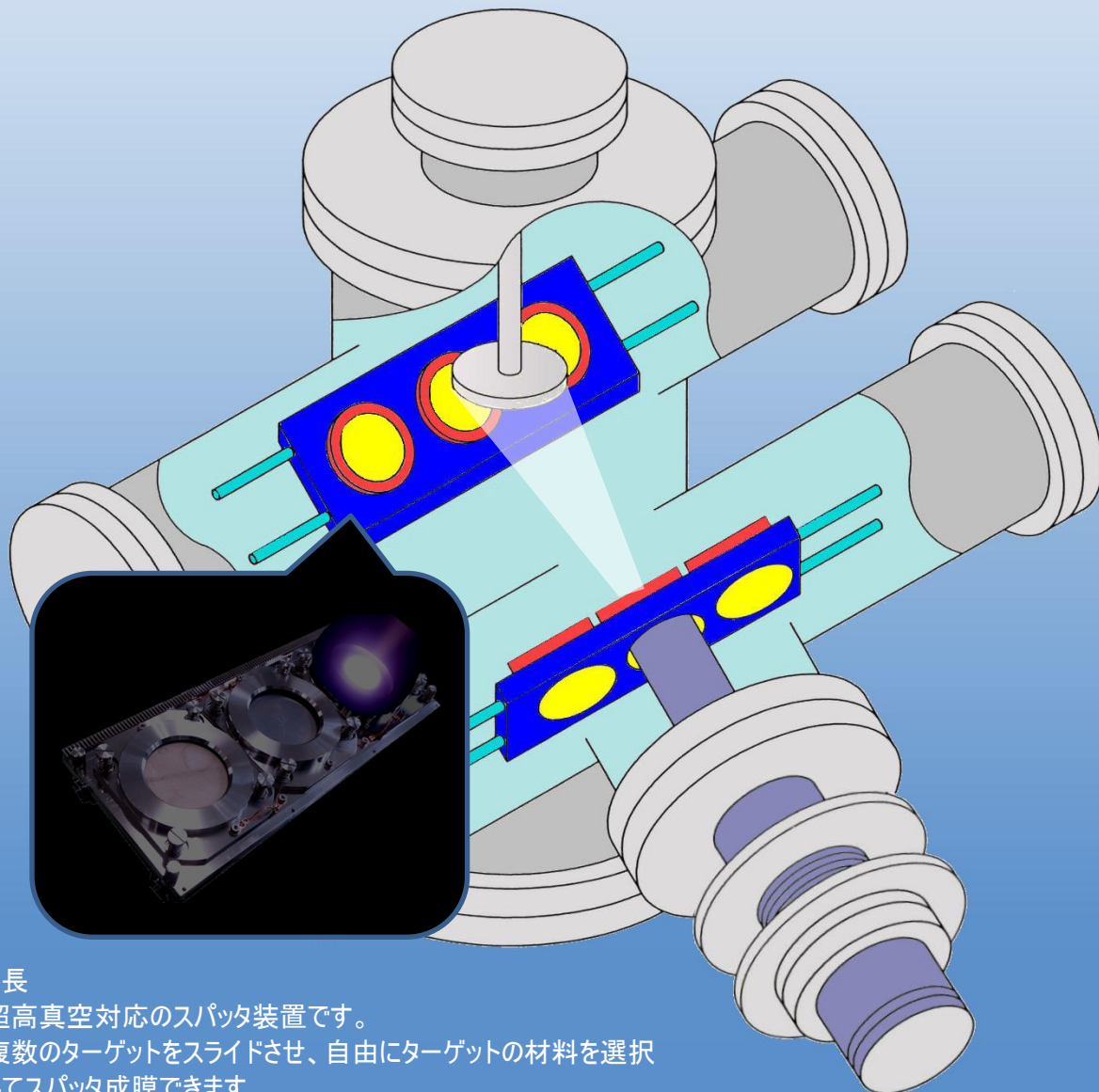


セレクトティブCoスパッタ装置

Selective Co-Sputter System

ESC-330W



■特長

1. 超高真空対応のスパッタ装置です。
2. 複数のターゲットをスライドさせ、自由にターゲットの材料を選択してスパッタ成膜できます。
 - ・真空一貫でターゲット選択
 - ・少ないスパッタ源で複数のターゲットがスパッタ成膜可能
3. 同時に2元スパッタさせて、Coスパッタ成膜ができます。
 - ・その際のターゲット組み合わせが自由に選択可能
4. 基板に対して斜めに配置しているので、膜厚分布が良好です。
5. 垂直型スパッタと比較した場合、ヒステリシス効果が得られます。
6. 酸化バリア膜成膜でプラズマダメージが図れます。(弊社垂直型オフセット式との比較による)
7. 膜厚センサー設置が1つで済む為、どのターゲットでも同じ条件で測定できます。

* 特許出願中